

天津中环半导体股份有限公司董事会

关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2010年12月31日止的“关于首次公开发行股票募集资金使用情况报告”。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]62号文核准，由主承销商渤海证券有限责任公司（现已更名为渤海证券股份有限公司）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为每股5.81元。至2007年4月12日公司新发普通股（A股）股票已全部售出，募集资金总额为人民币581,000,000.00元。减除发行费用人民币24,403,700.00元，实际募集资金净额为人民币556,596,300.00元。上述资金到位情况业经北京五洲联合会计师事务所（现已更名为五洲松德联合会计师事务所）验证，并出具五洲验字[2007]1-0007号《验资报告》。

2010年，公司对2007年预计未支付的发行费中的发行宣传费783,940.00元调整到收到的募集资金中，调整后的募集资金总额为557,380,240.00元。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核付款。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

三、募集资金的投向及变更情况

（一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	2006年投入金额	2007年投入金额	项目备案部门	批文号
6英寸0.35微米功率半导体器件生产线	60,960	11,374	49,586	天津市发展和改革委员会	津发改许可[2006]38号

单位：人民币万元

项目投资内容	计划投资额	项目建设期
建设工程费	4,394.48	20个月 (2006年5月至 2007年12月)
设备购置费	47,425.92	
工具器具及生产家具购置费	242.83	
其他工程和费用	1,660.19	
预备费(不可预见)	2,082.58	
建设期贷款利息	804.00	
铺底流动资金	4,350.00	
合计	60,960.00	

(二) 募集资金项目投资结构部分调整情况如下:

公司 2007 年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》，同意对募集资金项目投资结构及建设期进行适当调整，项目及投资总额均不变化。

股东大会决议变更后的募集资金使用计划情况如下:

单位：人民币万元

项目投资内容	计划投资额	项目建设期
建设工程费	10,480.00	23个月 (2006年5月至 2008年3月)
设备购置费	35,874.00	
工具器具及生产家具购置费	2,280.00	
其他工程和费用	532.00	
预备费(不可预见)	1,520.00	
铺底流动资金	4,000.00	
生产流动资金	6,274.00	
合计	60,960.00	

公司 2008 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于部分调整首发募集资金项目投资结构及建设进度的议案》，对募集资金投资项目建设期再次进行调整，项目及投资总额均不变化。

股东大会决议变更后的募集资金使用计划情况如下:

单位：人民币万元

项目投资内容	计划投资额	项目建设期
建设工程费	11,556.00	32个月 (2006年5月至 2008年12月)
设备购置费	37,368.00	
工具器具及生产家具购置费	1,408.00	
其他工程和费用	532.00	
预备费(不可预见)	1,000.00	
铺底流动资金	2,820.00	
项目管理及设备调试费	6,276.00	
合计	60,960.00	

四、首次公开发行股票募集资金投资项目资金实际存放及使用情况

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的规定,对募集资金制定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。公司董事会为本次募集资金批准开设了天津银行南开支行专项账户,其活期存款账户为:358901201090813982。截至2010年12月31日,公司募集资金帐户余额为420.16元,此金额为利息,募集资金已使用完毕。

截至2010年12月31日募集资金实际投资额557,380,240.00元,具体情况如下:

单位:人民币万元

募集资金总额: 58,100.00					已累计使用募集资金总额: 55,738.02				
变更用途的募集资金总额: 0.00					各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00					2007年: 37,692.62				
					2008年: 14,885.47				
					2009年: 1,784.36				
					2010年: 1,375.57				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
6英寸0.35微米功率半导体器件生产线	6英寸0.35微米功率半导体器件生产线	60,960.00	60,960.00	55,738.02	60,960.00	60,960.00	55,738.02	-5,221.98	2008年12月

说明：截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金帐户余额为 420.16 元，此金额为利息，募集资金已使用完毕。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2010 年 12 月 31 日公司利用募集资金归还募集资金投资项目“6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线”占用的银行专项贷款 221,457,407.69 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	2006 年实际投资额	2007 年 1—4 月实际投资额	截至 2007 年 4 月 30 日自筹资金实际投资额
6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线	113,743,277.14	107,714,130.55	221,457,407.69

2007 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过“关于用募集资金归还募集资金投资项目贷款的议案”，同意用募集资金归还募集资金项目于 2006 年 12 月 31 日前先期投入的专项贷款 113,740,000.00 元。

2007 年 6 月 12 日，第一届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过“关于用募集资金置换已投入募集资金项目贷款的议案”，同意用募集资金置换募集资金项目剩余专项贷款 107,717,407.69 元。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年 6 月 28 日，公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金 17,000 万元暂时补充流动资金，时间最长不超过 6 个月，从 2007 年 6 月起到 2007 年 12 月止。公司已于 2007 年 11 月 16 日归还了补充流动资金的款项。

2007 年 12 月 6 日，公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过了“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，时间最长不超过 4 个月，从 2007 年 12 月起到 2008 年 4 月止。公司已于 2008 年 4 月 2 日归还了补充流动资金的款项。

2008 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，时间最长不超过 3 个月，从 2008 年 4 月起到 2008 年 7 月止。公司已于 2008 年 7 月 8 日归还了补充流动资金的款项。

2008 年 7 月 7 日，公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，时间最长不超过 3

个月，从 2008 年 7 月起到 2008 年 10 月止。公司已于 2008 年 10 月 8 日归还了补充流动资金的款项。

七、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效 益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
			2008 年	2009 年	2010 年		
6 英寸 0.35 微米 功率半导体器件 生产线	76.56%	11,491.00	建设期	-6,131.06	-3,619.90	-9,750.96	否

未达到预计效益原因：

1、项目实施过程中市场变化和建设难度超过预期

项目建设实施过程中遇到一些前期无法预见的困难，外部因素主要来自于半导体产业周期和人民币升值的双重影响。2007—2008 年期间受半导体产业周期和行业竞争加剧的共同影响，全球市场 MOSFET 类产品代工价格大幅度下降，由原可研报告 15 美元/次光刻下降到 7 美元/次光刻；同时受人民币升值影响（由可研报告的 8.3:1 升值为 6.83:1）；综合表现代工价格累计下降 60%，同时 MOSFET 类产品价格下降了 50%。公司管理层针对市场变化和汇率变化带来的严峻局面和困难，调整募投项目的产业定位为代工为辅、自主产品为主，产品定位为半导体功率器件的战略方向，同时对项目建设的资源分配和部分工艺设备清单进行了调整。另一方面，设立天津环鑫科技发展有限公司（以下简称“环鑫公司”）进行半导体功率器件产品的自主研发、拓展 MOSFET 类产品以外的半导体功率产品的技术开发，同时创新经营模式。

2007—2008 年期间在项目建设实施过程中，由于项目厂房、动力配套系统的调整和滞延以及部分进口工艺设备交货延迟直接造成了建设期延长了 12 个月，建设期期间费用也相应上升。导致项目建设期延长的主要原因有：（1）净化厂房布局调整及一、二期建设计划变更；（2）设备采购时间延长；（3）外部供电质量造成设备调试时间加长。

2、金融危机和半导体产业周期共同影响

募集资金项目于 2008 年末基本完成项目建设，2009 年初进入试生产阶段，主要产品为 MOSFET。期间，受金融危机影响，市场快速萎缩，并进一步加重了产品价格大幅度下跌；为维持生产线的稳定，公司付出了巨大的努力。期间，一方面及时引进技术团队、调整工艺设备布局，将主要产品方向调整为肖特基类产品；另一方面，设立控股孙公司天津鑫天和电子科技有限公司，改革经营模式、扩大销售、拓展市场规模，实现了在 2009 年 4 季度开始规模化生产。

由于全年整体产量不足，固定费用分摊较大，该项目未能实现年度的达产预期，造成当期亏损6,131.06万元。

围绕着募投项目的加速达产和提高经济效益，2010年公司一方面继续加快该项目的产品结构和生产线布局的调整速度，强化环鑫公司和鑫天和公司的市场引导作用，提高产能利用率；另一方面，加快以新能源产品为导向的新一代肖特基、FRED类产品和新型节能型电力电子器件的研发，加快公司具有自主知识产权产品的投产速度，提高产品附加值，整体提升项目经济效益。

2010年度实现销售收入12,061.75万元，实现利润-3,619.90万元。

产品品种	项目设计 投产年产能 (第一年)	2009年 实际产量	产能 利用率%	项目设计投 产年产能 (第二年)	项目设计投 产季度产能 (第二年)	2010年 实际产 量	产能 利用率%
整流二极管	11700	6496	55.52%	18000	4500	4177	35.70%
肖特基二极管	11700	26290	224.70%	18000	4500	162969	1392.90%
MOSFET	270600	15221	5.62%	384000	96000	57941	21.41%
小计	294000	48007	16.33%	420000	105000	225087	76.56%

八、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司对首次公开发行股份的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。

天津中环半导体股份有限公司董事会

2011年03月16日